



TIC® 800G 系列是一种高性能、高性价比的导热界面材料，具备独特的晶粒定向结构，能够精确贴合器件表面，有效放大热传导路径与转换效率。在超过其相变温度50°C时，材料开始软化并发生相变，能够充分填充器件之间微小且不规则的接触缝隙，形成低热阻的界面，显著提升散热性能。

特性

- 》低热阻
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》低压力应用环境

应用

- 》功率转换设备
- 》电源与车用蓄电池
- 》大型通信开关硬件
- 》LED电视，灯具
- 》笔记本电脑

TIC® 800G 系列特性表						
产品名称	TIC® 805G	TIC® 806G	TIC® 808G	TIC® 810G	TIC® 812G	测试标准
颜色	灰色					目视
厚度 (inch/mm)	0.005" (0.127)	0.006" (0.152)	0.008" (0.203)	0.010" (0.254)	0.012" (0.305)	ASTM D374
密度 (g/cc)	2.6					ASTM D792
建议使用温度范围 (°C)	-40 ~ 125					兆科测试
相变温度 (°C)	50~60					兆科测试
导热系数 (W/mK)	5.0					ASTM D5470
热阻抗 (°C·in ² /W) @ 50 psi	0.014	0.018	0.020	0.024	0.028	ASTM D5470

标准厚度: 0.005" (0.127 mm) , 0.006" (0.152 mm) , 0.008" (0.203 mm) , 0.010" (0.254 mm) , 0.012" (0.305 mm)

如需不同厚度请联系本公司。

标准尺寸: 10" × 16" (254 mm × 406 mm) , 16" × 400" (406 mm × 122 mm) 。

TIC®800G系列片材供应时附有白色离型纸及底衬垫，模切半断加工可提供拉手，也可提供模切成单个形状样式试供。

压敏黏合剂：不适用于TIC®800G 系列产品。补强材料：无需补强材料。

全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208
台湾: +886-2-2277-1007
加拿大: +001-604-2998559
越南: +84-396852859

service@ziitek.com
www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd(兆科科技有限公司)及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek(兆科)本公司不对产品的适用性，可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek(兆科)及其标志为公司或关联



TIC800G-0525